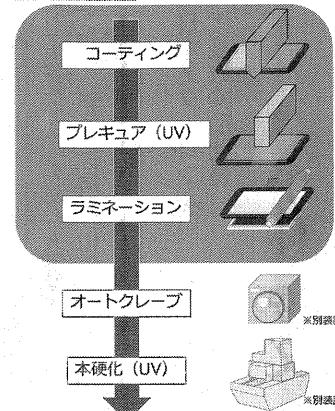


液晶パネル、タッチパネル向け貼り合わせ装置を開発している株FUK(奈良県御所市室1186-12、☎0745-631010)は、OCR(光学用UV接着剤)対応の貼り合わせ装置(写真)を開発した。従来方式と比べて生産性を向上するとともに材料コストを大幅に削減できる。現

プロセスフロー



プレキュアOCRのプロセス図

在特定顧客の評価中で、その成果をベースとしてハイスペック化し、2015年内をめどに製品化する予定だ。

スマートフォン(スマホ)に代表される小型タッチパネルでは、液晶パネルとカバーガラスを貼り合わせる際にOCRやOCA(透明粘着フィルム)を用いて空

気層を埋めるダイレクトボンディングが主流となっている。スマホの最上位機種では材料コストの観点からOCRが用いられているが、ディスペンサーで塗布した接着剤で貼り合わせるとはみ出るため拭き取りが必要で、その際の転着が不良の原因になるといった問題があった。

今回、同社はプレキュア(仮硬化)OCRを採用し、新たな手法の装置を中外炉工業㈱と共に開発した。中外炉のスリットコーターでカバーガラスに塗布キヤアOCRを平滑に塗布し、紫外光で仮硬化させてから液晶パネルと貼り合わせる。検査を経て本硬化させ、完成となる。

貼り合わせにはFUKの独自の大気中貼り合わせ技術を用い、支持治具(ピロ)」で持ち上げた基板をロ

ーラーにより片方から液晶

パネルに貼り付けていく。

これにより接着剤のはみ出

ないきれいな貼り合わせを実現し、拭き取りの手間を削減するとともに転着リスクを抑止し、材料使用量を最小限にできる。対応基板

FUK

OCR対応貼り合わせ装置

総コストを大幅削減

液晶・ディスプレー等の電子機器の生産性向上とコスト削減を目的とした新規機器を開発するFUKは、これ以外にも複数の装置の開発を進めており、基板の大型化への対応では、27型対応までを量産用装置としてラインアップ

FUKは、これ以外にも複数の装置の開発を進めており、基板の大型化への対応では、27型対応までを量産用装置としてラインアップ

サインボードやタブレット等の開発も行っている。

また、貼り合わせ以外の

複数の装置の開発を進めて

いる。基板の大型化への対

応では、27型対応までを量

産用装置としてラインアッ

トに展開する計画だ。

FUKは、これ以外にも複数の装置の開発を進めており、基板の大型化への対応では、27型対応までを量産用装置としてラインアッ

トに展開する計画だ。

LCD・OLED・AMOLED・SMD・SMT等の電子機器の製造装置

の開発・販売を行っている。

13年にはフィルムタッチセンサーの全自动製造装置を開発した。メタルメッシュフィルムタッチパネルを開発した。また、貼り合わせ以外の複数の装置の開発を進めており、基板の大型化への対応では、27型対応までを量産用装置としてラインアッ

トに展開する計画だ。

また、貼り合わせ以外の

複数の装置の開発を進めて

いる。基板の大型化への対

応では、27型対応までを量

産用装置としてラインアッ

トに展開する計画だ。

LCD・OLED・AMOLED・SMD・SMT等の電子機器の製造装置

の開発・販売を行っている。

13年にはフィルムタッチ

センサーの全自动製造装置

を開発した。メタルメッシ

ュフィルムタッチパネルを開

発した。さらに大型化に

向け貼り合わせ装置を開発

した。さらなる大型化に

向け貼り合わせ装置を開発</p